

比亚迪股份有限公司

关于拟筹划控股子公司分拆上市的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了更好地整合资源，做大做强半导体业务，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）有关《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的政策精神，比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月30日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟筹划控股子公司分拆上市的议案》，董事会同意公司控股子公司比亚迪半导体股份有限公司（以下简称“比亚迪半导体”）筹划分拆上市事项，并授权公司及比亚迪半导体管理层启动分拆比亚迪半导体上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

本次分拆事项不会导致公司丧失对比亚迪半导体的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，不会损害公司独立上市地位和持续盈利能力。

一、拟分拆上市主体的基本情况

（一）基本情况

- 1、公司名称：比亚迪半导体股份有限公司
- 2、法定代表人：陈刚
- 3、注册资本：45,000万元人民币
- 4、统一社会信用代码：91440300766363876J
- 5、注册地址：深圳市大鹏新区葵涌街道延安路1号
- 6、成立日期：2004年10月15日

7、股东持股情况：

序号	股东名称	股份数量 (股)	持股比例
1.	比亚迪股份有限公司	325,356,668.00	72.30%
2.	深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业(有限合伙)	13,235,292.00	2.94%
3.	先进制造产业投资基金(有限合伙)	11,029,410.00	2.45%
4.	深圳红杉智辰投资合伙企业(有限合伙)	8,823,528.00	1.96%
5.	Himalaya Capital Investors, L. P.	8,823,528.00	1.96%
6.	厦门瀚尔清芽投资合伙企业(有限合伙)	8,823,528.00	1.96%
7.	湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)	7,731,616.00	1.72%
8.	启鹭(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)	6,617,646.00	1.47%
9.	深圳中航凯晟汽车半导体投资合伙企业(有限合伙)	6,617,646.00	1.47%
10.	深圳市鑫迪芯投资合伙企业(有限合伙)	6,617,646.00	1.47%
11.	爱思开(中国)企业管理有限公司	6,617,646.00	1.47%
12.	中电中金(厦门)智能产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,970,588.00	0.88%
13.	中金浦成投资有限公司	2,205,882.00	0.49%
14.	中金启辰(苏州)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,205,882.00	0.49%
15.	深圳市伊敦传媒投资基金合伙企业(有限合伙)	2,205,882.00	0.49%
16.	湖北省联想长江科技产业基金合伙企业(有限合伙)	2,205,882.00	0.49%
17.	珠海睿丰投资管理中心(有限合伙)	2,205,882.00	0.49%
18.	招银成长叁号投资(深圳)合伙企业(有限合伙)	1,985,292.00	0.44%
19.	中金传化(宁波)产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,323,531.00	0.29%

20.	联通中金创新产业股权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）	1,323,531.00	0.29%
21.	珠海横琴安创领鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	1,323,531.00	0.29%
22.	新余华腾投资管理有限公司	1,102,941.00	0.25%
23.	苏州聚源铸芯创业投资合伙企业（有限合伙）	882,351.00	0.20%
24.	深圳安鹏创投基金企业（有限合伙）	882,351.00	0.20%
25.	珠海尚颀华金汽车产业股权投资基金（有限合伙）	882,351.00	0.20%
26.	深圳华强实业股份有限公司	882,351.00	0.20%
27.	上海元昊投资管理有限公司	882,351.00	0.20%
28.	张家港博华创业投资合伙企业（有限合伙）	882,351.00	0.20%
29.	广州佳诚九号创业投资合伙企业（有限合伙）	882,351.00	0.20%
30.	深圳市松禾创业投资有限公司	882,351.00	0.20%
31.	深圳市创新投资集团有限公司	882,351.00	0.20%
32.	平潭华业成长投资合伙企业（有限合伙）	882,351.00	0.20%
33.	深圳市惠友豪创科技投资合伙企业（有限合伙）	882,351.00	0.20%
34.	深圳市共同家园管理有限公司	882,351.00	0.20%
35.	深圳市碧桂园创新投资有限公司	882,351.00	0.20%
36.	中小企业发展基金（深圳南山有限合伙）	882,351.00	0.20%
37.	深圳市远致华信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	882,351.00	0.20%
38.	深圳市伯翰视芯半导体合伙企业（有限合伙）	882,351.00	0.20%
39.	Starlight Link Investment Company Limited	882,351.00	0.20%

40.	深圳市英创盈投资有限公司	661,765.00	0.15%
41.	深圳市天河星供应链有限公司	441,175.00	0.10%
42.	深圳市建信远致智能制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）	441,175.00	0.10%
43.	珠海火睛石网络科技有限公司	441,175.00	0.10%
44.	上海正海聚亿投资管理中心（有限合伙）	441,175.00	0.10%
45.	深圳市招银共赢股权投资合伙企业（有限合伙）	220,590.00	0.05%
合计		450,000,000.00	100.00%

8、经营范围：许可经营项目：半导体(集成电路、分立器件、光电器件及其它半导体产品)设计、制造及销售;半导体相关产品封装、测试及销售;半导体相关模组类产品设计、制造及销售;半导体相关材料及设备(含芯片、封装及其它材料)的研发、设计、制造及销售;半导体相关技术咨询、开发与转让;半导体相关软件的研发、设计、系统集成、销售和技术服务;半导体二手设备买卖;LED照明产品的研发、生产、销售、运营及工程安装;LED显示屏产品、路灯充电设计的研发、生产、销售、运营及工程安装;节能项目的运营、设计、工程施工及运营管理;合同能源管理;智慧路灯项目运营;其它相关配套服务;本企业产品及生产所需的设备、技术及原材料的进出口业务;自有物业租赁、设备租赁及其它相关租赁业务;自营和代理各类商品及技术的进出口及销售。(以上项目不涉及外商投资特别管理措施)

（二）比亚迪半导体最近三年业务发展情况

比亚迪半导体主要业务覆盖功率半导体、智能控制IC、智能传感器及光电半导体的研发、生产及销售，拥有包含芯片设计、晶圆制造、封装测试和下游应用在内的一体化经营全产业链。经过十余年的研发积累和于新能源汽车领域的规模化应用，比亚迪半导体已成为国内自主可控的车规级IGBT领导厂商。同时，在工业级IGBT领域，比亚迪半导体的产品下游应用包括工业焊机、变频器、家电等，将为其带来新的增长点。在其他业务领域，比亚迪半导体也拥有多年的研发积累、充足的技术储备和丰富的产品类型，与来自汽车、消费和工业领域的客户建立了长期紧密的业务联系。未来，比亚迪半导体将以车规级半导体为核心，同步推动

工业、消费等领域的半导体发展，致力于成长为高效、智能、集成的新型半导体供应商。

（三）股权结构及控股股东的股权关系

截至本公告出具之日，公司直接持有比亚迪半导体325,356,668股股份，持股比例为72.30%，为比亚迪半导体的控股股东。

二、授权事项

公司董事会授权公司及比亚迪半导体管理层启动比亚迪半导体分拆上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

三、本次分拆上市的目的和意义

半导体行业是科技发展的基础性、战略性行业，具有前期投入金额大、产能建设周期长等特点，对行业内公司的资金实力和技术创新能力均提出较高要求。近年来，为推动半导体产业发展，增强产业创新能力和国际竞争力，尽快解决产业薄弱环节一批核心技术“卡脖子”问题，国家密集出台相关鼓励和支持政策，从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等多个方面加大行业支持力度；同时，受益于5G通讯技术推动人工智能、汽车电子等创新应用的发展，半导体市场规模持续扩大。在政策支持叠加市场需求的大背景下，半导体行业的国产替代进程稳步进行。

比亚迪半导体作为国内自主可控的车规级IGBT领导厂商，在技术积累、人才储备及产品市场应用等方面具有一定先发优势。截至目前，比亚迪半导体已完成了内部重组、股权激励、引入战略投资者及股份改制等相关工作，公司治理结构和激励制度持续完善，产业资源及储备项目不断丰富，具备了独立运营的良好基础。本次分拆上市将有利于比亚迪半导体进一步提升多渠道融资能力和品牌效应，通过加强资源整合能力和产品研发能力形成可持续竞争优势，充分利用国内资本市场，把握市场发展机遇，为成为高效、智能、集成的新型半导体供应商打下坚实基础。

四、独立董事独立意见

本次筹划控股子公司分拆上市事项，有利于拓宽比亚迪半导体的融资渠道，支持比亚迪半导体持续研发和经营投入，提升公司和比亚迪半导体的持续盈利能力及核心竞争力。独立董事认为上述事宜符合公司的战略规划和长远发展需求，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益，待上市方案初步确定后，公司将根据相关法律法规，履行相应决策程序，审议分拆上市的相关议案，同意公司开始筹划控股子公司比亚迪半导体分拆上市事项，并授权公司及比亚迪半导体管理层启动分拆上市相关筹备工作。

五、风险提示

本次分拆上市尚处于前期筹划阶段，待公司管理层完成前期筹备工作后，公司董事会还需就分拆比亚迪半导体上市是否符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》等法律、法规及规范性文件的要求做出决议，并提请公司股东大会审议批准。本次事项的推进还需取得中国证监会、公司上市地交易所及比亚迪半导体拟上市地交易所等监管机构的核准和/或批准，本次分拆上市事项仍存在一定不确定性。

针对上述风险因素，公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意相关风险。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会

2020年12月30日